



DENSÍMETRO DE COMPACTACIÓN

SVM II



El SVM II es nuestro densímetro de compactación de última generación. Gracias a una versatilidad sin precedentes y sus funciones inteligentes, los ensayos de densidad por compactación son más fáciles y fiables que nunca.

La pantalla táctil de 7 pulgadas y alta resolución con una moderna interfaz favorece que el usuario se centre en la tarea más importante que debe cumplir el nuevo SVM II: los ensayos de densidad por compactación 100 % conformes con la USP/EP. Con las funciones de cálculo automático del TestAssist, al usuario se le guía paso a paso en el proceso del ensayo lo más rápido posible. Calcula automáticamente el índice de compactabilidad y la relación de Hausner, y también imprime los informes después de cada ensayo.

Aparte de la facilidad de uso, el SVM II es el densímetro de compactación más versátil que hemos fabricado hasta la fecha. El nuevo diseño del sistema SwitchPlate permite tener cinco versiones diferentes del SVM II, con USP 1, USP 2 o USP 3 en configuraciones de una o dos estaciones de ensayo o una combinación de ambos métodos. Y la mejor parte es que también se puede ampliar con el paso del tiempo.

El SVM II se ajusta a diversos métodos y normas: desde la USP 1 y USP 2 hasta la ASTM B527-15 y la DIN EN ISO 787-11:1995. Con el SVM II, los usuarios siempre acertarán al realizar ensayos de densidad por compactación validados y conforme a las normas.

DENSÍMETRO DE COMPACTACIÓN SVM II

DENSÍMETRO DE COMPACTACIÓN 5 EN 1

UN INSTRUMENTO, CINCO VARIANTES

El SVM II ofrece la misma versatilidad que los cinco modelos anteriores. Puede ejecutar ensayos según los métodos 1, 2 y 3 de la USP, y equiparse con una o dos estaciones de ensayo para un mismo método (USP 1, 2) o con una combinación de ambos. El USP 3 cuenta con accesorios independientes, puede instalarse en la estación uno o dos y utilizarse con cualquier placa SwitchPlate. Como opción, el usuario puede pasar de una variante a otra en cuestión de minutos. Esto convierte al SVM II en el densímetro de compactación más versátil que hemos fabricado.

SISTEMA INTELIGENTE SWITCHPLATE

Con el innovador sistema SwitchPlate, el SVM II es más flexible que nunca. Placas SwitchPlates disponibles:

- | USP 1 con una estación
- | USP 1 con dos estaciones
- | USP 2 con una estación
- | USP 2 con dos estaciones
- | Dos estaciones combinadas con USP 1 y USP 2

INTERFAZ DE USUARIO MODERNA CON TESTASSIST

El SVM II se controla a través de una pantalla táctil de alta resolución equipada con la moderna interfaz de usuario de ERWEKA. Gracias a la innovadora aplicación TestAssist, se va guiando al usuario a lo largo de todo el proceso del ensayo de densidad por compactación. El TestAssist calcula automáticamente la densidad por compactación, el índice de Hausner y el índice de compactabilidad; el usuario solo tiene que leer los valores de la probeta e introducirlos cuando se le solicite. Así se reducen los errores y se dispone de los resultados de la manera más rápida posible. El SVM II también está equipado con la función DirectHelp, que siempre ofrece asistencia y orientación con tan solo tocar un botón.

¡1, 2, ENSAYO!

La interfaz táctil del SVM II centra la atención del usuario en la tarea más importante que debe realizar este instrumento: el ensayo de densidad por compactación. El componente principal es el TestAssist, un asistente inteligente que verifica la viabilidad en tiempo real, ofrece ayuda y garantiza la conformidad de los parámetros introducidos según la USP/EP/JP. De este modo, el ensayo de densidad por compactación se vuelve sencillo y seguro. Pero las prestaciones del TestAssist no acaban ahí: todas las demás funciones, como el panel de control, el menú de evaluación o el menú de servicio también están diseñadas para conectar a los usuarios con el equipo lo más rápido posible.

TESTASSIST: ENSAYOS DE DENSIDAD POR COMPACTACIÓN MÁS FÁCILES QUE NUNCA

El TestAssist es un asistente integral y sencillo para ejecutar rápidamente los ensayos de densidad por compactación. Se guía al usuario paso a paso a través de la parametrización, así el TestAssist evita que se introduzcan datos incorrectos. Cuando se ejecuta el ensayo de densidad por compactación, la pantalla de la prueba muestra toda la información importante sobre el estado del ensayo en cualquier etapa. Al realizar los ensayos según los métodos de la USP, el TestAssist solicita al usuario que introduzca los valores requeridos. Después, calcula los resultados de la densidad de compactación, el índice de Hausner y el índice de compactabilidad de manera totalmente automática. ¡Con la ayuda inteligente del TestAssist los ensayos de densidad por compactación son más fáciles y rápidos que nunca!

INFORMES

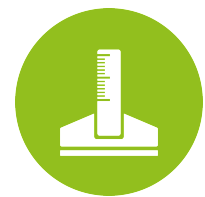
El asistente TestAssist del instrumento SVM II genera informes automáticamente después de cada ensayo. Estos informes se pueden imprimir directamente. Los últimos 10 informes de los ensayos se pueden recuperar y volver a imprimir.



Métodos 1, 2, 3 de la USP, norma
ASTM B527-15 y DIN ISO
787-11:1995



Interfaz táctil intuitiva



Una o dos estaciones de ensayo



Ampliable en cualquier
momento



El TestAssist calcula
automáticamente el índice de
compactabilidad y la relación de
Hausner



Parametrización en intervalos
adecuados

DENSÍMETRO DE COMPACTACIÓN SVM II

SWITCHPLATES

ERWEKA ofrece cinco SwitchPlates diferentes, incluida una clave de licencia que se compra con el nuevo SVM II. Todas las placas SwitchPlates son intercambiables si varían los requisitos y es posible adaptar cada SVM II con una nueva SwitchPlate. ¡El sistema SwitchPlate ofrece la máxima versatilidad y hace que cada SVM II esté perfectamente preparado para el futuro!

La instalación de una placa SwitchPlate del SVM II solo requiere dos pasos. Primero, el usuario cambia la placa en el SVM II fijándola con 6 tornillos pequeños. Segundo, se introduce el código de activación (que forma parte de la compra de un SwitchPlate) en el panel de configuración. De este modo la placa SwitchPlate específica se activa en el TestAssist y en el motor de informes del SMV II.

Se dispone de las siguientes SwitchPlates:



Esta placa tiene una estación de ensayo y puede ejecutar ensayos según el método 1 de la USP.



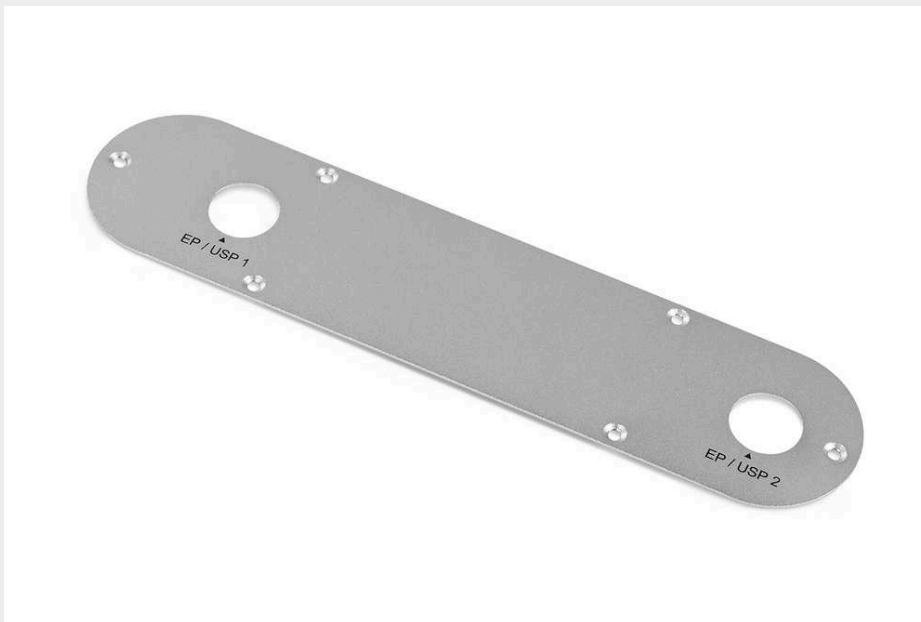
Esta placa tiene dos estaciones de ensayo y puede ejecutar ensayos según el método 1 de la USP.



Esta placa tiene una estación de ensayo y puede ejecutar ensayos según el método 2 de la USP.



Esta placa tiene dos estaciones de ensayo y puede ejecutar ensayos según el método 2 de la USP.



Esta placa tiene dos estaciones de ensayo y puede ejecutar ensayos según los métodos 1 o 2 de la USP.

DENSÍMETRO DE COMPACTACIÓN SVM II

ACCESORIOS

CAJA DE REDUCCIÓN DE RUIDO

La caja de reducción de ruido de ERWEKA es el complemento ideal para nuestro densímetro de compactación. Esta caja de reducción de ruido está fabricada con una carcasa de polímero resistente y revestida de un material amortiguador EPE en color blanco, con 30 mm de grosor. Reduce el ruido de un analizador de volumen por compactación hasta en 25 dB (A) de 100 a 75 dB (A).



DENSÍMETRO DE COMPACTACIÓN SVM II

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|--|
| Peso | 17 kg |
| Dimensiones (alt. x anch. x prof.) | 196,5 x 300 x 326 mm |
| Tensión | 115/230 V; 50/60 Hz |
| Fusibles | 1 A |
| Interfaces | USB A/B, Ethernet, RS232 |
| Clase de protección | I/EN 61140 |
| Tipo de protección | IP 21/IEC 529 |
| Control | Pantalla táctil de 7" y alta resolución |
| Estaciones de ensayo | 1 o 2 estaciones de ensayo utilizando 5 placas SwitchPlates diferentes |
| Métodos compatibles | <ul style="list-style-type: none"> - USP 1: 300 ±15 compactaciones/min; altura de compactación de 14 ±2 mm - USP 2: 250 ±15 compactaciones/min; altura de compactación de 3 ±0,2 mm - USP 3 según lo descrito en la USP <616> - Densidad aparente y densidad de compactación de polvos según EP 2.9.34 - Caudal de polvo según USP <1174> - Densidad de compactación de polvos y compuestos metálicos según ASTM B527-15 - DIN EN ISO 787-11:1995 Métodos generales de ensayo para pigmentos y extendedores |
| Almacenamiento de datos | 10 informes (temporalmente) |
| Exportación | Exportación en red con programa externo (Export Manager) en formato XML / PDF |
| Temperatura ambiente durante el funcionamiento | Desde +10 °C hasta +30 °C |
| Temperatura de almacenamiento y transporte | Desde +5 °C hasta +40 °C |
| Humedad relativa | Sin condensación del 25 al 80 % |